

GX708 采用小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装的可编程电阻器温度开关

1 特性

- 阈值精度:
 - 典型值±0.5℃
 - 最大值±3℃(+60℃至+100℃时)
- 由1%外部电阻器设定的温度阀值
- 低静态电流: 典型值为 33μA
- 开漏、低电平有效输出级
- 可通过引脚选择的30℃或者10℃温度滞后
- V_{CC}=0.8V上指定的复位操作
- 电源范围: 2.7V至5.5V
- 封装方式: 5引脚SOT23

2 应用范围

- 计算机(笔记本和台式机)
- 服务器
- 工业用和医疗用设备
- 存储区域网络
- 汽车用

3 芯片概述

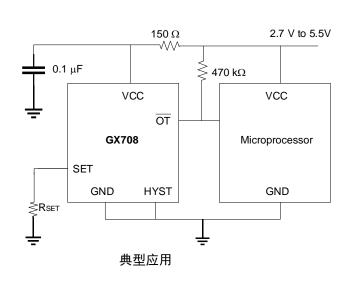
GX708是一款完全集成的、可编程电阻器温度开关,在其全工作范围内,只需一个外部电阻器即可设定温度 阀值。GX708 提供一个开漏、低电平有效输出和一个介于2.7V至5.5V的电源电压范围。

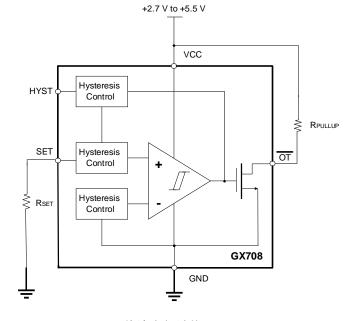
温度阀值精度的典型值为±0.5℃而最大值为±3℃ (+60℃至+100℃时)。静态流耗的典型值为 33µA。可 通过引脚选择来确定 30℃或者 10℃的温度滞后。

GX708采用5引脚SOT23封装。

芯片封装信息

产品编号	封装信息	芯片封装面积(NOM)
GX708	Die	0.919 mm × 0.579 mm
GX708S	SOT23-5	2.90 mm × 1.60 mm
GX708D	DFN6L	1.50 mm × 1.50 mm



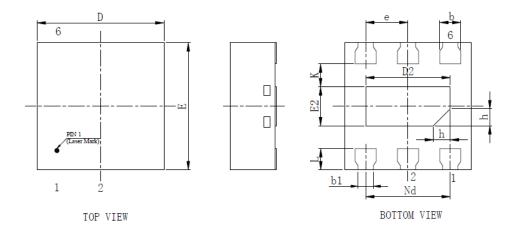


芯片内部结构图

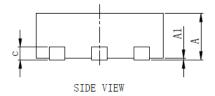


8 封装信息

DFN6L 芯片外形及 PCB 尺寸信息



SYMBOL	MILLIMETER			
SIMBOL	MIN	NOM	MAX	
A	0. 50	0.55	0.60	
A1	0	0.02	0.05	
b	0. 20	0. 25	0.30	
b1	0. 18REF			
С	0. 152REF			
D	1. 45	1. 50	1. 55	
D2	0. 90	1.00	1. 10	
e	0. 50BSC			
Nd	1. 00BSC			
E	1. 45	1. 50	1. 55	
E2	0. 36	0.46	0. 56	
L	0. 20	0. 25	0. 30	
h	0. 15	0. 20	0. 25	
K	0. 27REF			



9 订购信息

购买编码	器件	封装	标准包装数量	备注
GX708-T&R	GX708	Die	3000	裸片出货
GX708S-T&R	GX708	SOT23-5	3000	卷带包装
GX708D-T&R	GX708	DFN6L	4000	卷带包装